

MZIT

麟酷® LMDG-60系列产品规格说明书

Lincool® LMDG Serial Products Datasheet

中科院理化所及清华大学团队科技成果转换项目

Lincool®LMDG60系列液态金属单组份导热凝胶在厚、薄间隙情况下均适用，使用过程中不固化，液态金属的引入使系列凝胶具备良好的导热性、绝缘性、低热阻、高温耐受性等特征。



基础性能	LMDG-60	测试标准
颜色	蓝灰色	目测
热导率 (W/m·K)	6.5	ASTM D5470
最小粘结厚度值 (mm)	0.03	ASTM D5470
出胶量速率 (g/min)@30psi	13.3	30cc胶管无针头点胶
出胶量速率 (g/min)@90psi	3.2	30cc胶管配合1.3mm针头点胶
密度 (g/cm ³)	2.9	ASTM D792
体积电阻率 (Ω·cm)	10 ¹³	GB/T1672-1988
介电强度 (KV/mm)	0.8	IEC 60156-2018
连续使用温度 (°C)	-45~200	—
腐蚀性 (铜、铝、铁) @100°C	无腐蚀	SH/T 0331-1992
非挥发物含量 (%) @125°C, 24h	99.82	HG/T 2502-1993

特征与优势

1. 抵抗热冲击能力
2. 优异的延展性，低应力易实现高压缩比
3. 高界面润湿性，降低界面热阻
4. 高效热传递性能
5. 良好的电气绝缘性
6. 耐高低温、耐水、抗臭氧、耐气候老化
7. 传统凝胶的共有性质

使用方法

1. 清洁表面，将需要涂覆的待点胶表面，除去污渍、锈迹、灰尘和油污等
2. 通过自动点胶机或手动挤压（推荐使用点胶机）等方法将胶点到元器件表面点胶量根据元器件表面积确定
3. 使用时应避免胶量过多导致挤压后泄露
4. 涂抹时应避免在胶料中掺入杂质，点胶时应无气泡

产品应用

3C产品 通讯基站 显卡芯片 微处理器 汽车电子设备 散热模块

有效管理高功率密度及其产生的极端热量
为军事，激光，车载和航空航天应用设计